

半導体部品の高精度な形状測定

- バンプ高さ・コプラナリティ、端子面の粗さ/酸化膜段差
- CMP後のディッシング/エロージョンの面内マップ
- ダイシング後のチップング量、溝形状、サイドウォール角
- 実装部品（サブストレート、インターポーザ）上の微小段差・うねり
- 治具・チャックの平面度、微小欠け/バリの定量

非接触三次元測定機 アリコナ G6

形状測定

寸法測定

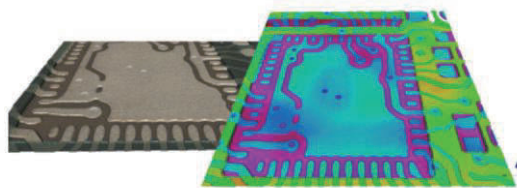
粗さ測定

差分測定

幾何公差測定

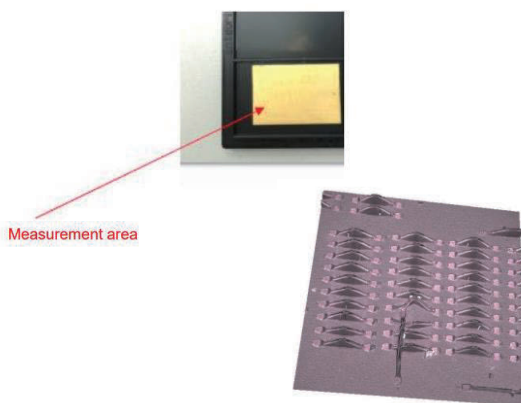


半導体関連部品の測定事例

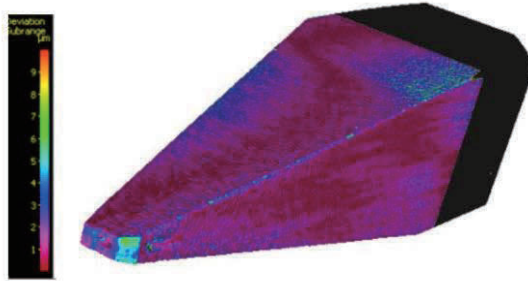


Measurement of shape and flatness for flawless attaching with silicone chips

ICチップ



ワイヤーボンディング



ボンディングツール先端部の差分解析(未使用品と使用済み品との比較評価)

製品ラインナップ



アリコナ μCMM

- ハイエンドモデルです。
- 最高精度の測定を最短の測定時間でご提供します。
- 310mm x 310mmのテーブルで大型ワークにも対応します。
- 研削加工やコーティングを施した鏡面の測定も可能です。



Focus X

- アリコナG6をコンパクトにしたモデルです。
- アリコナG6と同レベルの測定精度で、小型部品の形状測定や粗さ測定に最適です。
- コンパクトでも2軸電動制御の回転ユニットによる全周測定が可能です。
- 高いコストパフォーマンス